Kiru Kezuru Migaku

DISCO

Electroformed Bond Blades

NBC-Z SERIES

幅広いアプリケーションに対応する高性能ブレード

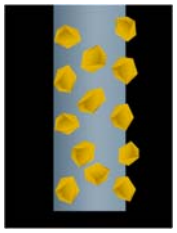
ウェーハダイシングから基板切断まで対応する
優れた研削力を持つNBC-Zシリーズ

NBC-Zシリーズはディスコ独自の技術が生んだ高性能極薄ブレードです。電鋳タイプのボンドを使用することで優れた研削力とロングライフを同時に実現しました。豊富な製品ラインアップにより、半導体ウェーハのダイシングのほかセラミックスやCSPなど半導体パッケージの切断などにも幅広く対応します。

- ●極薄ブレードによる深切り加工や溝入れ加工が可能
- ●0.015 mm～0.3 mmのブレード厚さに対応
- ●豊富な粒径やボンド品種により化合物半導体ウェーハのダイシングからセラミックスの切断加工まで幅広い加工に対応
- ●ダイシングソーのほか、スライサーでの使用も可能

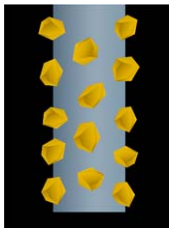
NBC-Zタイプ

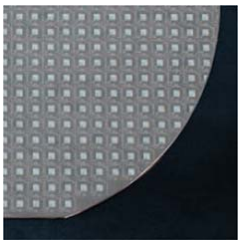
ブレード強度を重視した構造により極薄ブレードを実現。狭ストリートのダイシング加工や溝入れ加工などに適しています。

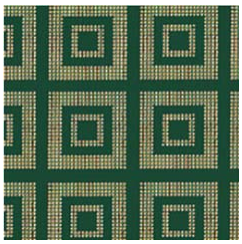


NBC-ZBタイプ

ブレード側面の状態を改善することで表面チッピングや斜め切れを低減し、優れた加工結果を提供します。



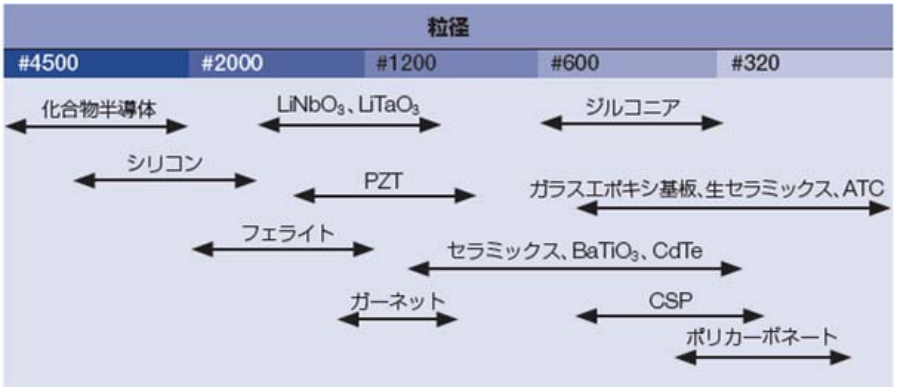

シリコンウェーハ


CSP

加工対象	シリコンウェーハ、化合物半導体ウェーハ（GaAs、GaPなど）、各種半導体パッケージ、他

加エデータ

粒径別アプリケーション



仕様

集中度	
1	低集中度
2	標準集中度

表面処理		
なし	片面砥粒突出タイプ	
L	ラップタイプ	Zタイプのみ
N	強度向上タイプ	
V	両面砥粒突出タイプ	ZBタイプのみ

厚さ精度※2,3	
G2	±0.005
G3	±0.002
G	特殊仕様

(mm)

※2 標準精度の場合は表示されません。
※3 品種、サイズにより標準精度は異なります。

外径	厚さ	内径	先端角度 θ
56	0.15	40	45°

※1NBC − Z 1 09 0 L G2 S3 T1

品種
Z
ZB

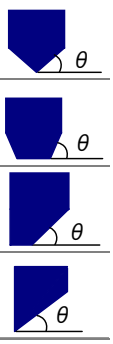
粒径			
13	#240	08	#1200
14	#280	07	#1500
12	#320	06	#1700
28	#360	05	#2000
11	#400	04	#3000
25	#500	03	#3500
10	#600	27	#4000
09	#700	02	#4500
21	#800	26	#4800
24	#1000		

※1 特殊仕様を含む製品は、ZBT−****と表示する場合があります。

ボンド	
O	標準タイプ
J	ソフトタイプ

スリット※4			
S1		割数	4
		深さ	1mm
S2		割数	8
		深さ	1mm
S3		割数	16
		深さ	1mm
S4	小割	割数	60
		深さ	1mm
	大割	割数	12
		深さ	2mm
S5		割数	40
		深さ	1mm
SS		特殊仕様	

先端形状※5: T1, T2, T3, T4



※4 スリット幅は全て0.5mmです(SSは除く)。
ブレード厚さ0.04mm以上より対応可能です。
※5 ブレード厚さ0.1mm以上より対応可能です。

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当員が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。
・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますので、ご確認の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。

⚠ 安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- ●安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- ●制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- ●精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- ●精密加工ツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ●使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ●ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ●改造された機械(装置)は使用しないでください。
- ●機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- ●切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- ●湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。